

证券代码：301338

证券简称：凯格精机

公告编号：2025-004



东莞市凯格精机股份有限公司

2024 年年度报告摘要

2025 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☐不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯格精机	股票代码	301338
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱靖琳	刘丹	
办公地址	东莞市东城街道沙朗路 2 号	东莞市东城街道沙朗路 2 号	
传真	0769-22301338	0769-22301338	
电话	0769-38823222-8335	0769-38823222-8335	
电子信箱	ir@gkg.cn	gkg@gkg.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是国家级高新技术企业，荣获国家制造业单项冠军企业、专精特新“小巨人”企业，国家知识产权示范企业、广东省博士后创新实践基地等称号，拥有“广东省精密机械工程技术研究中心”，“广东省电子器件生产装备 CAE 应用技术企业重点实验室”。公司主要产品为锡膏印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡膏印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备主要应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、医疗器械、航空航天、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半

导体封装环节，可应用于 LED 照明及显示器件、半导体芯片封装环节。公司在全球七十多个国家和地区注册了商标“GKG”，产品销往全球五十多个国家与地区。

1、锡膏印刷设备

公司锡膏印刷设备主要应用于 SMT（电子装联）及 COB 工艺中的印刷工序，通过将锡膏印刷至 PCB/基板上，进而实现电子元器件/裸芯片与 PCB 裸板/基板的固定粘合及电气信号连接，属于 SMT 及 COB 工艺中的核心环节。同时，公司的锡膏印刷设备还能应用于半导体先进封装领域，通过将锡膏/银膏/环氧树脂均匀印刷至焊盘/晶圆表面，进而实现芯片与基板间的电气互联。设备稳定性、加工精度及工艺能力，对成品封装模组的可靠性、耐久性等性能具有重要影响，公司锡膏印刷设备处于全球领先水平。

随着电子产品和 LED 显示器件发展逐渐小型化、轻薄化；PCB 表面组装的电子元器件集成度越来越高；英制 0201、英制 01005、公制 M03015、公制 M0201 等超小规格元器件及 0305、0204 等微小型芯片应用日渐普及， SMT 及 COB 工艺亦随之蓬勃发展。锡膏印刷设备具备高精度化、高智能化、高稳定性已成为基础应用要求。随着 SMT、COB 与电子信息技术同步发展的态势，锡膏印刷设备在电子装联中所发挥的作用也日渐突出。

公司锡膏印刷设备的核心型号如下：

产品名称	产品图示	应用领域
Climber 系列 SL200		半导体领域晶圆 Wafer 印刷+植球工艺
G-Ace500		满足手机、电脑、汽车电子等高精密、高稳定性、高产出效率印刷要求，及智能化工厂、无人化工厂需求
R1		适用于小型 5G、智能穿戴、半导体如 IGBT 等产品印刷要求
GLLED-mini III		满足 Mini LED/Micro LED 技术路线高精密印刷及巨量转移要求

产品名称	产品图示	应用领域
Pmax-pro		满足数据中心、5G 类等服务器、基站大尺寸、高难度线路板印刷要求
X60		满足玻璃基无需载具的印刷工艺，适配 Mini LED COG 路线显示需求

2、封装设备

公司的封装设备主要应用于 LED 及半导体封装环节的固晶工序，固晶设备是一种将裸芯片从晶圆转移至载具基板/引线框架上并实现芯片的固定或粘合的自动化设备，公司同时掌握了 Pick & Place 和刺晶两种技术路线。

公司封装设备的核心型号如下：

产品名称	产品图示	应用领域
GD200 系列 半导体高精度固晶机		适用于半导体领域（QFN、DFN、SMA、SOD、卷式 SIM）、共晶工艺（车规级贴装、光通讯贴装、COB 大功率）等产品应用
GD612 高精密固晶机		适用于半导体领域、QFN、DFN 等多种晶粒/芯片类的产品固晶。
GDM 系列固晶设备		适用于 Mini LED 直显、Mini LED 背光及 COB、COG（玻璃基）、MIP 多合一等产品应用

产品名称	产品图示	应用领域
GD80 系列固晶设备		适用于 LED 照明、LED 显示屏等器件的芯片固晶工序

3、点胶设备

公司点胶设备主要应用于电子装联环节和半导体制程环节的点胶工序。电子装联环节主要是通过将胶水喷射在 PCB 板或者元器件上，实现电子元器件与 PCB 板的固定、粘合、封装及填充，具有防水、防尘、散热、防震、保护等作用，为电子装联的基础生产工序之一，对产品的品质、寿命等具有重要影响。

公司半导体点胶设备主要应用于晶体管、集成电路等器件的封装和保护。半导体行业对品质和可靠性要求极高，要求点胶机能够保证涂覆胶水的均匀性和一致性，避免器件受到损伤或腐蚀，公司的点胶设备能有效的满足上述要求，从而提升客户产品质量和长期稳定性。

公司点胶设备的核心型号如下：

产品名称	产品图示	应用领域
D-semi 半导体点胶设备		适用于半导体点锡、底部填充、BGA 焊球强化、芯片级封装、腔体填充、晶元粘贴密封帽、芯片封装、导电胶等
D/DH 系列点胶机		适用于消费电子、泛网络产品、汽车电子、新能源、Mini LED 等行业的红胶、UV 胶、UF 胶、硅胶、锡膏、银浆等点胶工艺应用
Q200D		适用于 VR、TP 侧边封胶、曲面屏点胶、TWS、LCD 屏圆孔点胶等五轴点胶应用

产品名称	产品图示	应用领域
A400/A200D 柜式机		适用于 SMT 领域、3C 行业、汽车电子、新能源、半导体封装
C400/C200D 桌面机		适用于 SMT 领域、3C 行业、汽车电子、新能源、半导体封装
D-Tec 3D 胶路检测设备		专用于点胶后的 3D 胶路检测，检测胶水胶宽/胶高(厚度)/断胶/零件表面覆盖效果/漏胶/拉丝/散点/边缘平滑度/高度差/平行度，尤其可以用于透明胶水的识别

4、柔性自动化设备

公司柔性自动化设备（FMS）主要应用于电子装联及组装环节中对应工序的柔性化制造，柔性自动化设备将电子装联工序分为通用部分和特定功能部分，其中通用部分为 FMS 平台，特定功能部分通常是运输模块、操作模块、功能模块、上料模块的组合。通过通用部分与特定功能部分的灵活组合，实现不同的功能，从而达到柔性制造的目的。

FMS 以标准设备平台为基础，通过匹配不同的执行模块，能让设备实现不同的自动化功能，为客户减少了因不同生产需求而购买不同功能设备的成本和繁琐的更改产线工作量，使设备的使用效率最大化，使电子制造厂商实现“设备共享模式”成为可能。

公司柔性自动化设备的核心产品如下：



FMS 产线示意图

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐是 ☒否

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	2,315,057,020.67	2,144,030,719.92	7.98%	1,863,227,661.96
归属于上市公司股东的净资产	1,465,852,252.61	1,412,199,785.28	3.80%	1,397,407,594.26

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	856,602,024.45	740,021,358.32	15.75%	779,338,101.52
归属于上市公司股东的净利润	70,516,160.08	52,577,113.51	34.12%	127,096,750.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,581,566.40	39,675,731.24	60.25%	118,494,085.72
经营活动产生的现金流量净额	-81,198,878.13	17,665,296.90	-559.65%	34,481,183.22
基本每股收益（元/股）	0.66	0.49	34.69%	1.43
稀释每股收益（元/股）	0.66	0.49	34.69%	1.43
加权平均净资产收益率	4.91%	3.74%	1.17%	16.16%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	154,491,401.12	204,900,032.26	217,986,006.32	279,224,584.75
归属于上市公司股东的净利润	10,770,359.97	16,726,224.03	16,541,277.53	26,478,298.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,372,065.75	14,598,212.67	14,702,858.95	24,908,429.03
经营活动产生的现金流量净额	-77,936,966.20	-29,513,084.91	-12,123,299.13	38,374,472.11

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,804	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,064	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邱国良	境内自然人	36.18%	38,500,000	38,500,000	不适用	0
彭小云	境内自然人	23.03%	24,500,000	24,500,000	不适用	0
海口凯格创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.58%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
国信证券一兴业银行一国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.32%	1,409,641	0	不适用	0
东莞市凯创投投资顾问中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.04%	1,111,250	1,111,250	不适用	0
东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	988,750	988,750	不适用	0
王新虎	境内自然人	0.28%	302,600	0	不适用	0
陈坤速	境内自然人	0.27%	291,300	0	不适用	0
黄剑华	境内自然人	0.26%	276,700	0	不适用	0
卢盛林	境内自然人	0.23%	247,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		邱国良与彭小云为夫妻关系；邱国良担任海口凯格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）的执行事务合伙人，实际控制海口凯格创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市凯创投投资顾问中心（有限合伙）、东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）；国信证券一兴业银行一国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划为公司首次公开发行股份员工参与战略配售集合资产管理计划。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

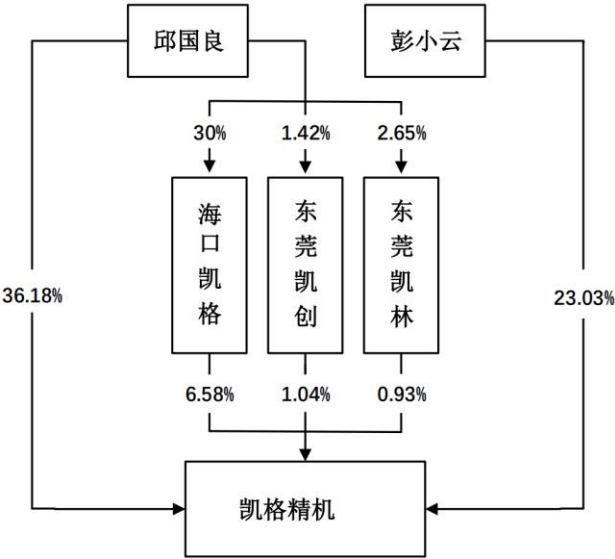
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

不适用